

奇景光電與聯發科技、曠視科技合作，推出領先業界首款 Android 智慧型手機之主動式立體 3D 感測相機解決方案

提供具成本效益的臉部辨識和安全線上支付

【台南，2018 年 9 月 5 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（5）日宣布，和領先業界智慧型手機平台聯發科技股份有限公司（聯發科技）、以及擁有世界上最大臉部識別開放平台 Face++ 的中國北京曠視科技有限公司（曠視科技，Megvii, Ltd.），共同合作推出業界首款、應用於 Android 智慧型手機臉部辨識和安全線上支付的主動式立體 3D 感測相機（ASC，Active Stereoscopic Camera）參考設計，此項解決方案具有極佳成本效益和優越性能，已獲得多家智慧型手機廠，積極評估導入於下一代產品。

主動式立體 3D 感測相機解決方案，是由聯發科技立體匹配深度引擎（Stereo Matching Depth Engine）、曠視科技的 Face++ 人工智慧的計算機視覺演算法，結合奇景尖端投影機、CMOS 影像感測器及雷射驅動 IC 所構成。奇景提供的關鍵技術為用於投影機中，基於世界領先的晶圓級光學鏡頭（WLO，Wafer Level Optics）技術，所做的繞射光學元件（DOE，Diffractive Optics Element）及準直鏡、高效率雷射驅動 IC、高精度主動式對準投影機組裝技術，以及接收器中兩個高靈敏度近紅外光 CMOS 影像感測器。相對於結構光 3D 方案，主動式立體 3D 感測相機解決方案擁有較低成本的優勢，目標是大眾市場智慧型手機機型，用於臉部識別、安全線上支付，以及基於 AI 算法的影像增強功能。

此款業界首見的主動式立體 3D 感測相機解決方案，奇景 3D 感測技術主要有五大特點：第一是帶有編碼的 DOE 和準直鏡客製化紅外線投影機，將 7,000 至 10,000 個隱形點投射到物體上，建構精密的 3D 深度地圖；第二是用於 940nm 波段的高量子效率感測器，於室內室外環境皆具有出色的感測能力；第三是專利的玻璃破碎檢測機制，當投影機發生玻璃破裂時，客製化雷射驅動 IC 會主動將雷射關閉；第四是確保眼睛安全，通過國際雷射產品標準 IEC 60825 一級認證，該認證主要是規範雷射在所有肉眼正常使用條件下的產品安全；第五是小型化模組尺寸及低功耗，是嵌入式及行動裝置的理想選擇。

奇景光電執行長吳炳昌表示，很高興與聯發科技、曠視科技合作，此強大聯盟確保 Android 大眾市場能夠更容易採用 3D 感測，創造更優質的用戶體驗。奇景相信主動式立體 3D 感測相機解決方案，將有助於在 2019 年起，幫助 Android 智慧型手機廠，更廣泛地採用 3D 感測應用。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D 感測及機器視覺的 CMOS 影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,200 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本、以色列與美國。至 2018 年 6 月 30 日為止，奇景光電在全球已取得 2,997 項專利，尚有 442 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

劉欣杰 / Ken Liu
投資人關係 專案副理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
ken_liu@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
Greg Falesnik, Managing Director
MZ North America
Tel: +1-212-301-7130
Email: greg.falesnik@mzgroup.us
www.mzgroup.us

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2017 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。